**第四届全球半导体产业（重庆）博览会**

**The 4th Global Semiconductor Indestry (Chongqing）Expo**

第四届未来半导体产业发展大会

单位参会报名表

时间：2022年6月29-30日 地点：重庆国际博览中心

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |   |
| **单位地址** |   |
| **联系人** |  | **职位** |  |
| **手机号** |  | **电子邮箱** |  |
| **会议安排** | **编号** | **会议内容** | **时间** |
| 1 | 主会场 | 6.29上午 |
| 2 | 集成电路设计论坛 | 6.29下午 |
| 3 | 封装测试论坛 | 6.29下午 |
| 4 | 智能汽车芯片论坛 | 6.30上午 |
| 5 | 智能手机芯片论坛 | 6.30上午 |
| 6 | 川渝半导体产业投资对接会 | 6.30下午 |
| **参会人员信息** |
| **姓名** | **职务** | **电话** | **电子邮箱** | **入座会议****（**填写编号即可） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. 根据新冠防疫要求，所有参会人员须身份实名登记，请您完整详细填写《单位参会报名表》后递交组委会，做好日程安排准时参会。组委会将与贵单位取得联系并确定参会人员信息。
2. 时间：2022年6月29-30日 地点：重庆国际博览中心
3. 报道流程：出示身份证+渝康码通过安检、测体温→报到处签到→领取参会证→进入会议室
4. 咨询组委会：王女士18883191601 邮箱1248554892@qq.com
 |